

(19)日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2001-313274

(P2001-313274A)

(43)公開日 平成13年11月9日 (2001.11.9)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>  
H 0 1 L 21/304  
B 2 8 D 5/04

識別記号  
6 1 1

F I  
H 0 1 L 21/304  
B 2 8 D 5/04

テーマコード(参考)  
6 1 1 B 3 C 0 6 9  
6 1 1 A  
C

審査請求 未請求 請求項の数 5 OL (全 13 頁)

(21)出願番号 特願2000-130527(P2000-130527)

(22)出願日 平成12年4月28日 (2000.4.28)

(71)出願人 000152675  
株式会社日平トヤマ  
東京都品川区南大井6丁目26番2号

(72)発明者 石井 豊  
神奈川県横須賀市神明町1番地 株式会社  
日平トヤマ技術センター内

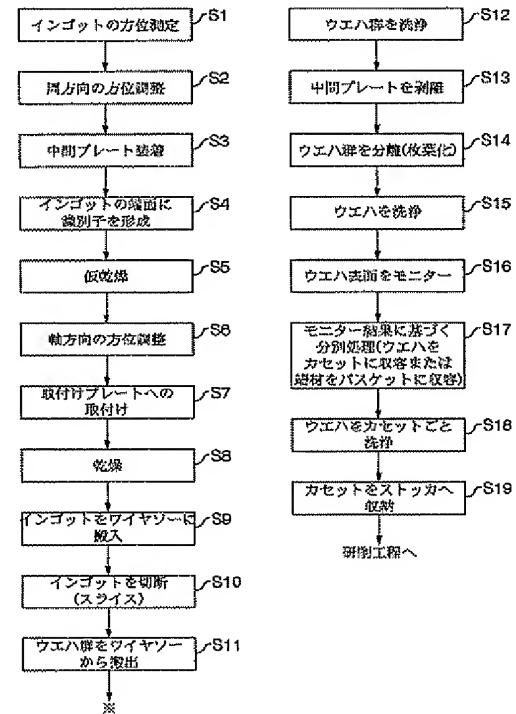
(74)代理人 100091513  
弁理士 井上 俊夫  
Fターム(参考) 3C069 AA01 BA06 CA04

## (54)【発明の名称】 ウエーハの回収方法

## (57)【要約】

【課題】 ワイヤソーによりインゴットを切断した後、ウエーハを回収するにあたり、端材の処理が容易であり、自動化に対応できるようにすること、また複数本のインゴットを一括してスライスベースに取り付けて切断した後、ロット毎にウエーハを回収することが容易であることを。

【解決手段】 複数のインゴットの各端面に例えば塗布手段によりインクを塗布しておき、これらインゴットを直列にワイヤソーに装着して切断し、多数のウエーハ群を得、その後枚葉化する。そしてウエーハを1枚ずつベルト搬送と共に、撮像手段によりウエーハの表面をモニタし、その画像を処理して識別マークの有無を判定する。識別マーク有りと判定されたウエーハ(端材)はバスケットに廃棄され、その他のウエーハはカセット内に収納されると共に、端材の検知のタイミングによりカセットを交換してロットごとのウエーハの区分けを行う。



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 インゴットの端面に識別子を形成する工程と、

インゴットをスライスベースに接着させる工程と、  
インゴットをスライスベースを介してワイヤソーに装着して切断し、ウエーハ群を形成する工程と、  
この工程で形成されたウエーハ群をスライスベースから剥離して枚葉化する工程と、

枚葉化されたウエーハの表面を監視手段により監視し、  
識別子の有無を判定する工程と、

識別子が有ると判定されたウエーハを他のウエーハと区別して回収する工程と、を含むことを特徴とするウエーハの回収方法。

【請求項2】 識別子の検知に基づいてロットの切り替わりを判断し、ウエーハをロットごとに区分けして回収する工程を含むことを特徴とするウエーハの回収方法。

【請求項3】 インゴットをワイヤソーにより切断する工程は、種類の異なる複数のインゴットをスライスベースを介してワイヤソーに装着して行われることを特徴とする請求項1または2記載のウエーハの回収方法。

【請求項4】 監視手段は、ウエーハの表面を光学的に監視するものであることを特徴とする請求項1、2または3記載のウエーハの回収方法。

【請求項5】 識別子は、インゴットの端面に塗布液を塗布して形成した識別マークであることを特徴とする請求項4記載のウエーハの回収方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、インゴットをワイヤソーにより切断（スライス）して得られたウエーハの端材を回収する方法、及び複数のインゴットを切断して得られたウエーハを回収する方法に関する。

## 【0002】

【従来の技術】 シリコン単結晶やシリコン多結晶のインゴットからIC用ウエーハ、太陽電池用ウエーハを得る手法の一つとして、ワイヤソーと呼ばれる装置が用いられている。この装置は、例えば1本のワイヤを複数のローラ間に所定ピッチで巻き付けてなるワイヤ群を構成し、ローラの回転によりワイヤを高速走行させながらインゴットをワイヤに押し付けると共に砥粒を含むスラリをインゴットとワイヤとの接触部に供給して、シリコン結晶を複数の薄板状に同時に切断してウエーハ群を得るものである。

【0003】 このときインゴットはスライスベースを介して取付け板に接着されており、この取付け板がワイヤソーの支持機構に装着される。そして切断後はスライスベースに接着されているウエーハ群を例えば薬液に浸漬して接着剤を溶かし、ウエーハ群を互に分離して枚葉化している。一方シリコンインゴットの場合、予めインゴットの結晶方位を測定し、その結果に基づいてワイヤの

走行方向に対するインゴットの向き、つまりインゴットの回転方向及び水平方向の結晶方位を調整し、結晶方位が調整された状態でインゴットが切断（スライス）される。このためインゴットの両端部のウエーハ（端材）は両面が平行でないことが多く、また欠けたりすることもあり、枚葉化されたウエーハを次工程でカセットに移すときに、作業者がこれら端材を取り除いてラインから外すようにしていた。

【0004】 また最近では複数のインゴットを直列に並べてスライスベース及び取り付け板を介してワイヤソーに装着し、同時に切断することも行われており、この場合には作業者が端材を取り除くと共に、各インゴットに対応するウエーハごとに区分けしてカセットに移し替えるようにしている。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 上述のようにインゴットを切断した後のウエーハ群を回収する際に端材を作業者が取り除かなければならないため、ワイヤソーの後工程の自動化の対応が困難であるという問題があった。また複数本のインゴットを同時に切断する場合には、更に各インゴットに対応するウエーハごとに区分けしなければならないため、自動化の対応がより一層困難である。

【0006】 本発明は、このような事情の下になされたものであり、その目的は、インゴットを切断した後、ウエーハを回収するにあたり、端材の処理が容易であり、自動化に対応しやすい技術を提供することにある。また本発明の他の目的は、複数のインゴットを切断した後、各インゴットごとにウエーハを回収することが容易な技術を提供することにある。

## 【0007】

【課題を解決するための手段】 本発明に係るウエーハの回収方法は、インゴットの端面に識別子を形成する工程と、インゴットをスライスベースに接着させる工程と、インゴットをスライスベースを介してワイヤソーに装着して切断し、ウエーハ群を形成する工程と、この工程で形成されたウエーハ群をスライスベースから剥離して枚葉化する工程と、枚葉化されたウエーハの表面を監視手段により監視し、識別子の有無を判定する工程と、識別子が有ると判定されたウエーハを他のウエーハと区別して回収する工程と、を含むことを特徴とする。

【0008】 本発明において、インゴットの端面に識別子を形成する工程は、インゴットをスライスベースに接着させる工程の前であっても後であってもよいし、あるいはインゴットを切断した後であってもよい。また識別子としては、例えばインゴットの端面に塗布液を中心部または略全域に塗布して形成した識別マークを挙げることができ、監視手段としては、ウエーハの表面を光学的に監視するもの例えば画像処理装置や光センサなどを挙げができる。なおウエーハの表面を監視するときは、ウエーハの縁部に識別マークが付されていてこの識

別マークを検知する場合も含む意味である。更に本発明は、識別子の検知に基づいてロットの切り替わりを判断し、ウエーハをロットごとに区分けして回収する工程を含むようにしてもよい。更にまたインゴットをワイヤソーにより切断する工程は、種類の異なる複数のインゴットをライスベースを介してワイヤソーに装着して行われる場合も含む。

#### 【0009】

【発明の実施の形態】以下に本発明に係るウエーハの回収方法の実施の形態について説明する。図1は本実施の形態の全体の流れを示す工程図である。はじめに単結晶あるいは多結晶シリコンからなるインゴットをワイヤソーに装着する前までの工程について図1及び図2を参照しながら説明する。ワイヤソーには種類の異なる例えば3個のインゴットが一括して取り付けられるが、図2では図示の便宜上、2個のインゴット1がラインを流れている様子について示している。

【0010】先ず図2(a)に示すように、インゴット1は支持台2の一対の回転ローラ21、21の上に載せられ、照射ヘッドPからインゴット1の外周面にX線が照射されると共に、測定器Qで受波したX線の波長や強度などに基づいてインゴット1の回転方向及び水平方向の結晶方位が測定される(ステップS1)。

【0011】次いでステップS2にて、図示しないモータにより回転ローラ21を回転させてインゴット1をその軸線回りに回転させ、回転方向の方位を調整し、更に図2(b)に示すようにインゴット1の外周面に図示しない接着機構により接着剤を用いて、ライスベースである中間プレート11を接着する(ステップS3)。然る後、ステップS4にてインゴット1の端面に識別子である識別マークを形成する。この工程は、例えば図2

(c)に示すように塗布手段であるインカーラー3を端面10に近接して対向するように位置させ、インカーラー3から塗布液であるインク30を吐出して、例えば端面10の中央部に識別マークMを形成する。そして例えばこのステップS4と並行してステップS5にて図2(d)に示すように、インゴット1の両側から乾燥機22によりにより前記接着剤に熱風を当てて当該接着剤を乾燥する仮乾燥工程を行う。

【0012】続いて図2(e)に示すように、方位調整機構23の把持部24がインゴット1を両側から把持して鉛直軸Hの回りに回転させ、インゴット1の水平方向の結晶方位を調整する(ステップS6)。更にステップS7にて図示しない接着機構により前記中間プレート11の上に接着剤により取付けプレート12を接着し(図2(f))し、図2(g)に示すようにインゴット1の両側から乾燥機25によりインゴット1、中間プレート11及び取付けプレート間の接着剤に熱風を当ててそれら接着剤を乾燥させる乾燥工程を行う(ステップS8)。以上の工程は、支持台2がインゴット1を載せた

状態で、図示しないガイド機構により順次下流側に搬送されることにより行われる。

【0013】次にステップS9にて前記インゴット1をワイヤソーに搬入する。図3はワイヤソー4の要部を示す図であり、例えば3個の加工用ローラ41、42、43間に1本のワイヤ40が所定ピッチで連続的に巻回されており、被切断物であるインゴット1から見ると多数のワイヤが並行に張設された格好になっている。ワイヤ40の両端は、図示していないが、夫々巻取リール及び繰出しリールの間に張力調整機構を介して張られている。このワイヤ40の走行は加工用ローラ41、42、43の回転により、一定量前進及び一定量後退を繰り返し、全体的に歩進的に前進するよう行われる。そして中間プレート11を介して例えば3個のインゴット1が取り付けられた取付けプレート12を支持機構44に着脱自在に装着すると共に、ワイヤ40を走行させ、前記支持機構44を下降させて各インゴット1をワイヤ40に押し付けながら、砥粒を含むスラリを接触部に供給し、各インゴット1を切断して(ライスして)ウエーハ群を形成する(ステップS10)。

【0014】こうしてインゴット1の切断工程が行われた後、インゴット1を取付けプレート12ごと支持機構44から取り外してワイヤソー4から搬出し(ステップS11)、図4に示すように剥離装置にてウエーハ群を中間プレート11からの剥離させる。剥離装置は、治具51が設けられた液槽52を備えており、図4(a)に示すように取付けプレート12を支持機構53に支持させて当該支持機構53を下降させ、図4(b)に示すように、薬液が溜められた液槽52内にウエーハ群W1、W2、W3を浸漬する。なおこの例では種類の異なる3本のインゴット1を取付けプレート12に取り付けているので、3種類のインゴット1に対応するウエーハ群を夫々W1、W2、W3としている。

【0015】このときウエーハ群W1、W2、W3は前記治具51内に収まる位置であってかつ当該治具51から若干浮いた位置に置かれ、また取付けプレート12の下縁部は液面より下方側に位置することとなる。この結果ウエーハ群W1、W2、W3は前記薬液により洗浄される(ステップS12)と共に、ウエーハ群W1、W2、W3(インゴット1)及び中間プレート11間の接着剤が薬液により溶解し、ウエーハ群W1、W2、W3が自重により中間プレート11から剥離して治具51内に落下する(ステップS13)。その後図4(c)に示すように支持機構53により取付けプレート12を引き上げる。この後に取付けプレート12から中間プレート11が取り外される。

【0016】次いでステップS14にて図5に示すようにウエーハ群W1、W2、W3を一枚づつ分離する(枚葉化する)。この枚葉化工程は、例えば前記水槽52から取り出された治具51を、直線に伸びるガイド60に

沿って移動可能な移動台61の上に載置して、ウエーハWの1枚の厚さに相当する量だけ移動台61を間欠移動させると共に、前記ガイド60と平行な軸の回りに垂直面に沿って旋回し先端部に吸着パッドを備えた吸着アーム62により、前記治具51の先頭に位置するウエーハWから順に1枚ずつ吸着保持して例えればベルト搬送が行われる洗浄用搬送路63の上流端位置Rに移載する。このとき吸着アーム62は治具51からウエーハWを取り出した後、90度回転してウエーハWを水平姿勢にして前記上流端位置Rに移載する。

【0017】またウエーハWの移動路の直ぐ上には、吸着アーム62により吸着分離されるウエーハWに密着して後続のウエーハWと一緒に移載されるのを防止するため、いわば2枚取り防止用の仕切り板64が設けられている。この枚葉化工程は、例えれば前記水槽52内にて治具51が移動できる装置を用い、吸着アーム62により水槽内のウエーハWを1枚ずつ取り出すようにしてもよい。枚葉化されたウエーハWは洗浄用搬送路63に沿ってブラシローラ65及び洗浄部66に送られてスクラブ洗浄される(ステップS15)。

【0018】スクラブ洗浄されたウエーハWは図6に示すように、ウエーハ回収ステーション内の搬送ベルト7の上流端に搬送される。搬送ベルト7の周辺には上流側から順に、ウエーハWの表面を表裏両面側から撮像する撮像部(カメラ)71、71ウエーハWの厚さを測定する厚さ測定部81、インゴット1の端部に位置するウエーハWである端材を収納するバスケット82が設けられ、搬送ベルト7の下流端に臨む位置には、多数のウエーハWを棚状に保持するためのカセット9がカセット支持機構91に支持されている。なお搬送ベルト7としては、下方側の撮像部71がウエーハWの表面を撮像できるように、例えばウエーハWの両側部を支持する、平行な2本のベルトなどが用いられる。

【0019】前記撮像部71、71には画像処理部72が接続され、ここで当該撮像部71で撮像された画像を処理してウエーハW表面に前記識別マークMが有るか否かを判定する。なおこの例では撮像部71及び画像処理部72により、ウエーハW表面を監視して識別マークMの有無を判定する監視手段が構成される。またこのウエーハ回収ステーションは、端材をバスケット82に排出する例えは吸着アームなどからなる端材排出手段83と、カセット支持機構91上のカセット9を交換するカセット交換手段84とを備えており、制御部85によりこれら手段83、84が制御されるようになっている。

【0020】ここでウエーハ回収ステーション内における処理の流れについて説明する。搬送ベルト7の上流端に順次載置されたウエーハWは下流側に搬送されると共に、前記監視手段(撮像部71、71及び画像処理部72)により、これらウエーハWの表面が監視(モニタ-)され(図1のステップS16)、次いでそのモニタ

一結果に応じてウエーハWに対して分別回収処理がされる(図1のステップS17)。この一連の処理を図7のフローチャートに基づいて詳しく述べると、先ず撮像部71によりウエーハWの表面が撮像され(ステップS20)、次いで厚さ測定部81によりその厚さが測定される。この厚さの測定値は後工程で使用するデータとして取り込まれる。一方撮像部71、71は撮像したウエーハWの表面の画像を画像処理部72に出力し、画像処理部72はその画像に基づいて識別マークMの有無を判定する(S21)。識別マークMの判定結果は制御部85に送られ、識別マークが無いと判定された場合には、カセット交換手段84及び端材排出手段83を駆動するなく、そのウエーハWを支持機構91上のカセット9内に搬送する(ステップS22)。支持機構91はウエーハWを受け取るたびに降下し、これによりカセット9内には下から順にウエーハWが積層されていく。

【0021】これに対し、識別マークMが有ると判定された場合には、そのウエーハWは端材であるから、端材排出手段83を駆動して当該ウエーハWをバスケット82に排出し(ステップS23)、そして一つ前のウエーハWに識別マークMが付されていたか否かを判断する(ステップS24)。一つ前のウエーハWに識別マークMが付されていなければ、その端材はロット(当該ウエーハWが切り出されたインゴット1に属するウエーハWの群)の終りであるから、即ちそのウエーハWが切り出されたインゴット1の最後のウエーハWであるから、図8に示すように前記支持機構91を後側に回転させて搬出ベルト92の上に移載すると共に、カセット交換手段84を駆動して支持機構91に別のカセット9を載置する(ステップS25)。

【0022】一方ステップS24にて一つ前のウエーハWに識別マークMが付されていると判断された場合には、その端材はロットの始まりであり、この時点では既に前記ステップS25にてカセット9が交換されているので、このままフローを終了する。なお新しいロットの開始時点で、つまりロットの先頭の端材を検出したときにカセット9を交換するようにしてもよい。

【0023】前記搬出ベルト92に移載されたカセット9は洗浄ステーションに搬送されてそこでウエーハWがカセットごと洗浄され(図1のステップS18)、ストッカに収納される(ステップS19)。その後ウエーハWは研削工程に送られる。

【0024】上述の実施の形態によれば、インゴット1の端面に識別マークMを付し、ウエーハWの表面をモニターして識別マークMの有無を判定し、これによりウエーハWが端材であるか正常ウエーハであるかを認識するようにしているため、インゴット1を切断(スライス)した後の端材の処理を自動で行うことができ、またマルチでインゴット1を切断したとき、即ち種類の異なる複数のインゴット1を切断したときに得られるウエーハW

を各ロットごとに回収することができる。この結果、インゴットを切断して得られたウエーハW群をカセットに挿入するまでの工程を自動化することができる。

【0025】以上において本発明は、1個のインゴットを取り付けプレート12に取付けて切断する場合にも適用できるし、あるいは同じ種類の複数のインゴット1を取り付けプレート12に取付けて切断する場合にも適用できる。また識別マークを付すタイミングは、中間プレート11を取り付ける前であってもよいし、インゴット1を切断した後であってもよい。更にウエーハWの表面を監視する手段としては画像処理を行うものに限らず、例えば光反射センサーを用い、反射強度の大きさに応じて識別マークの有無を判定するようにしてもよい。また、識別マークはインゴットの端面の略全域に塗布液を塗布して形成したものでもよい。また識別マークを各ロットに応じたものとし、例えばバーコードを付すようにし、そのバーコードを読み取って、そのロットに対応するカセットを選択してウエーハWを収納するようなシステムを組んでもよい。更にまた識別子としてウエーハWに磁性体を貼り付け、磁界の変化を検出して端材の有無を判定する場合なども本発明の範囲に含まれる。なおインゴットとしてはシリコン材に限らず磁性体などであってよい。

#### 【0026】

【発明の効果】以上のように本発明によれば、端材の処理が容易であり、また複数のインゴットを切断する場合には各インゴットごとにウエーハを回収することができる、自動化に対応しやすいという効果がある。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】本発明方法に係る実施の形態の工程全体を示す工程図である。

【図2】上記の実施の形態においてインゴットをワイヤソーに装着する前までの工程を示す説明図である。

#### 【図3】ワイヤソーの要部を示す斜視図である。

【図4】インゴットを切断して得られたウエーハ群を中間プレートから剥離させる工程を示す説明図である。

#### 【図5】ウエーハ群を枚葉化する工程を示す説明図である\*

\*る。

【図6】ウエーハの表面を監視し、監視結果に基づいてウエーハを区分けする工程を示す説明図である。

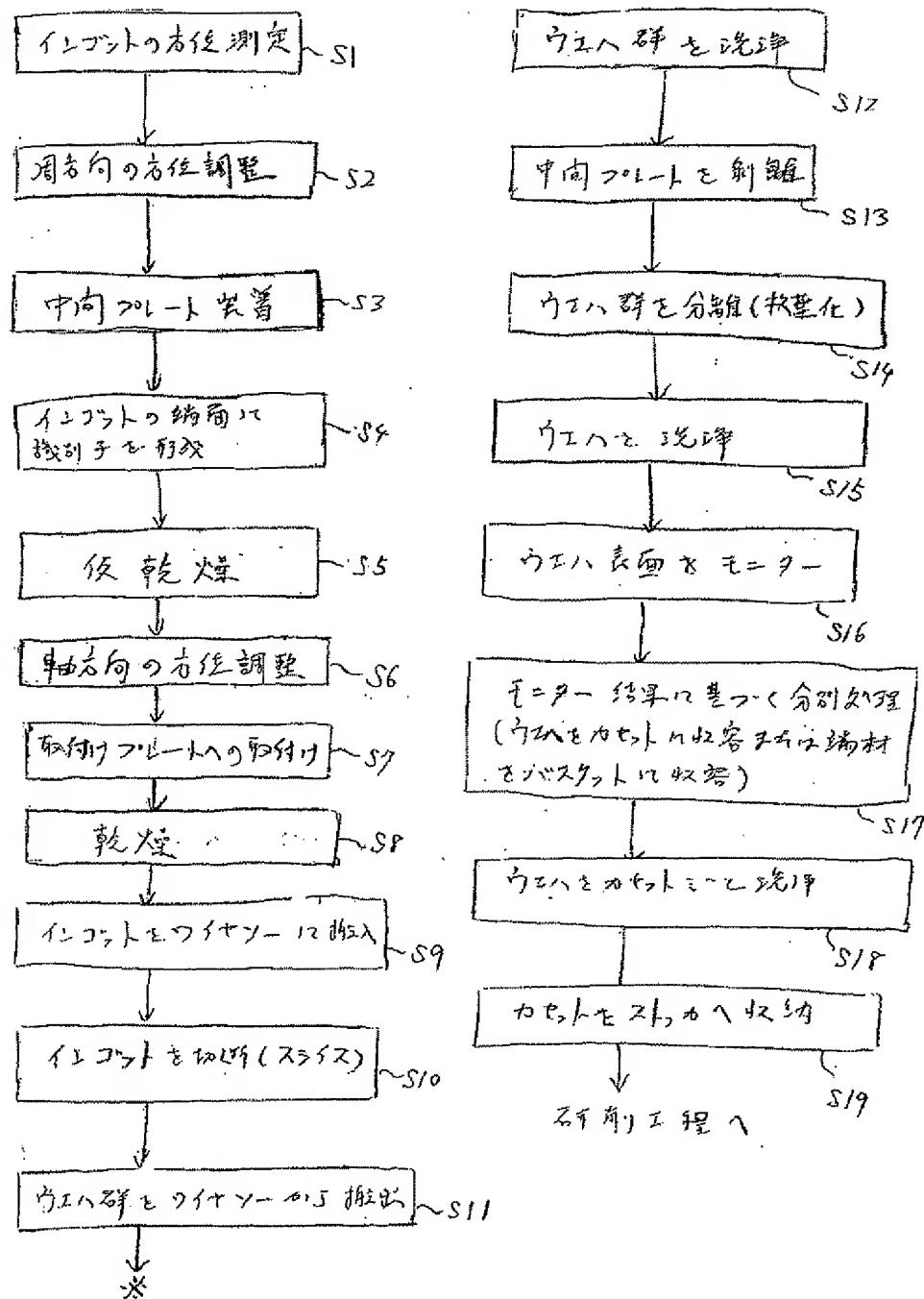
【図7】ウエーハの表面を監視し、監視結果に基づいてウエーハを区分けする工程を示すウエーハ一枚毎のフローチャートである。

【図8】カセット支持機構上のカセットを交換する様子を示す説明図である。

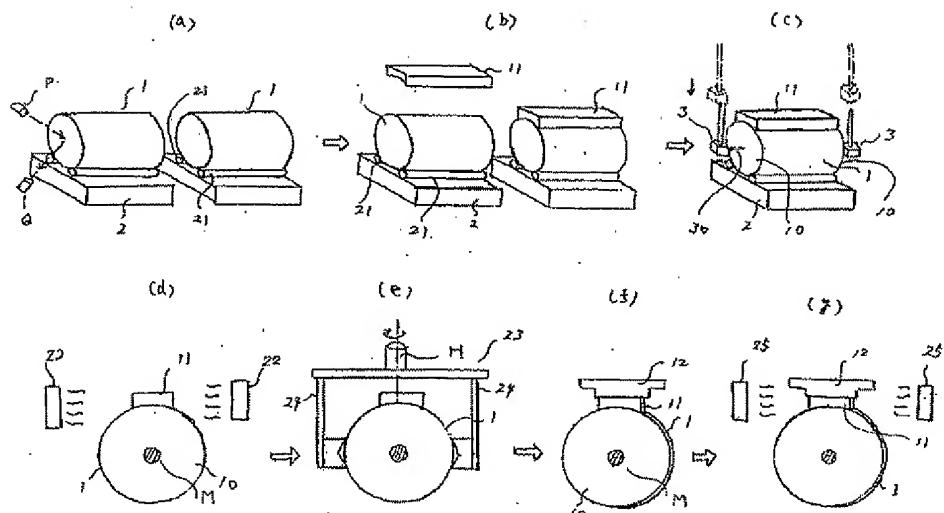
#### 【符号の説明】

10	1	インゴット
	11	中間プレート
	12	取付けプレート
	2	支持台
	21	ローラ
	22、25	乾燥機
	23	方位調整機構
	3	塗布手段であるインカ
	M	識別マーク
	4	ワイヤソー
20	40	ワイヤ
	41、42、43	加工用ローラ
	51	治具
	52	液槽
	W1、W2、W3	ウエーハ群
	W	ウエーハ
	61	移動台
	62	吸着アーム
	65	プラシローラ
	66	洗浄部
	7	搬送ベルト
	71	撮像手段
	72	画像処理部
	81	厚さ測定部
	82	端材収納用バスケット
	85	制御部
	9	ウエーハカセット
	91	支持機構

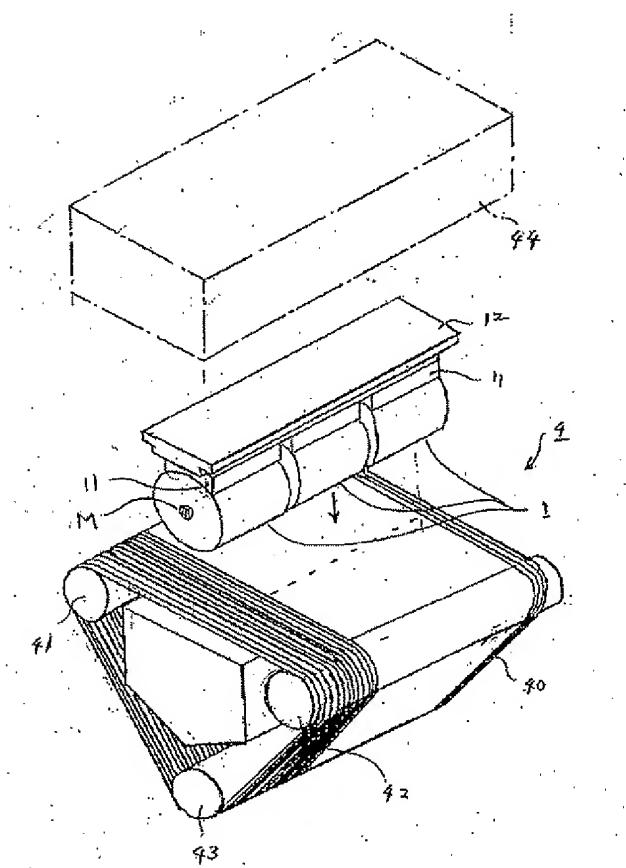
【図1】



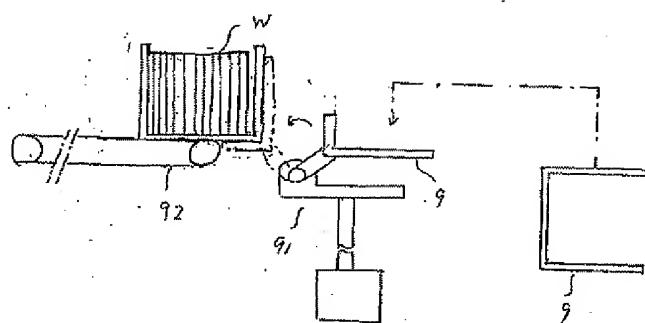
【図2】



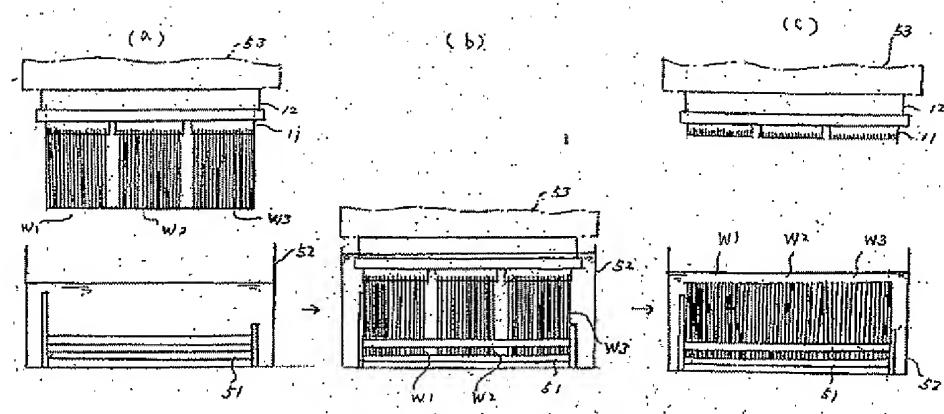
【図3】



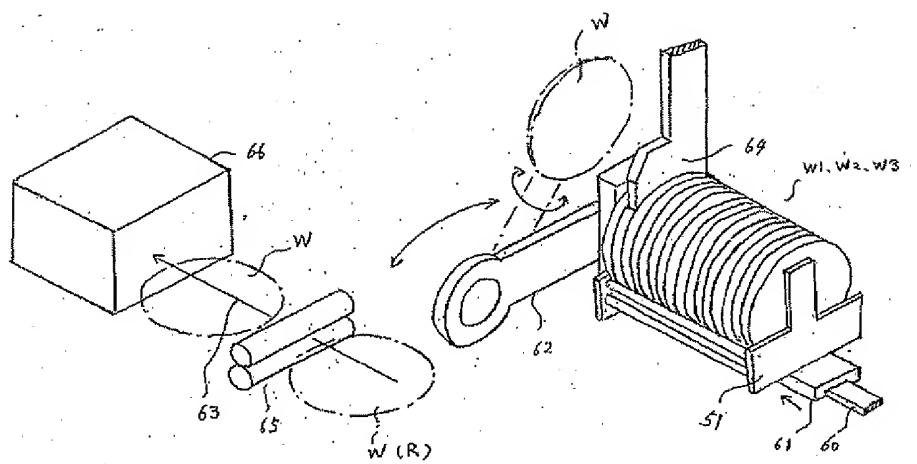
【図8】



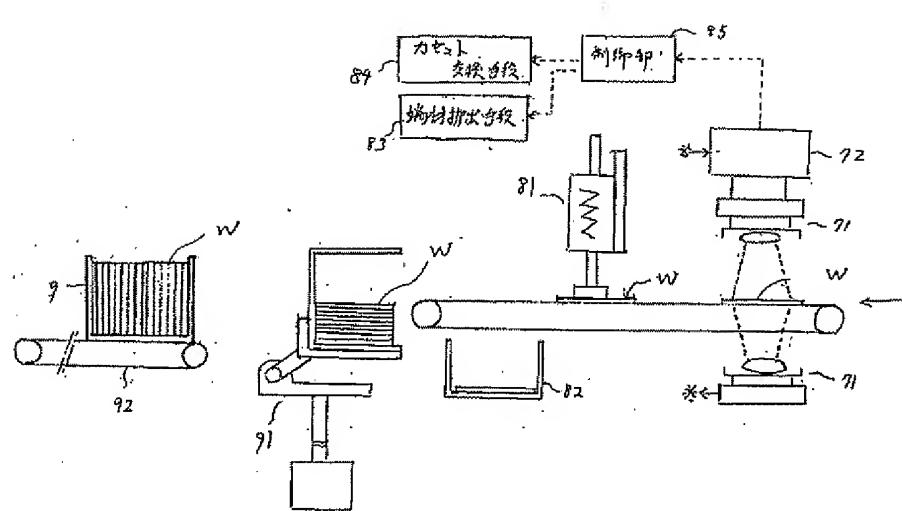
【図4】



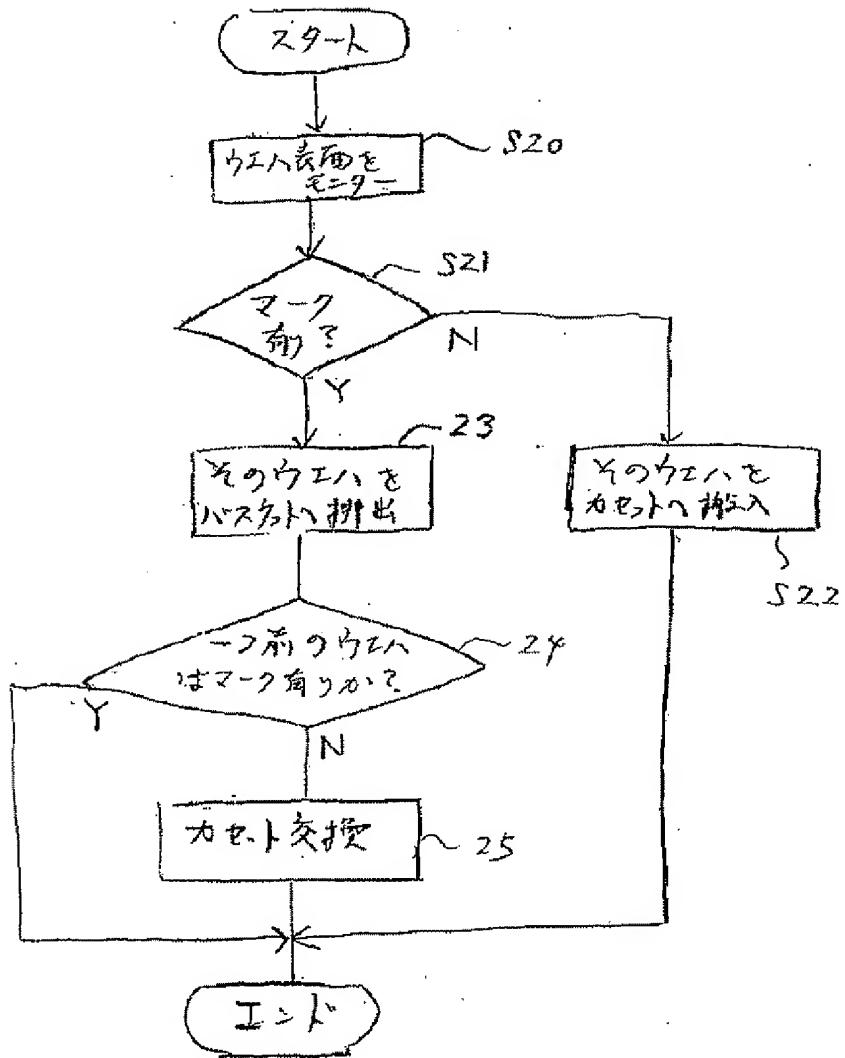
【図5】



【図6】



【図7】



## 【手続補正書】

【提出日】平成12年5月12日(2000.5.12)  
2)

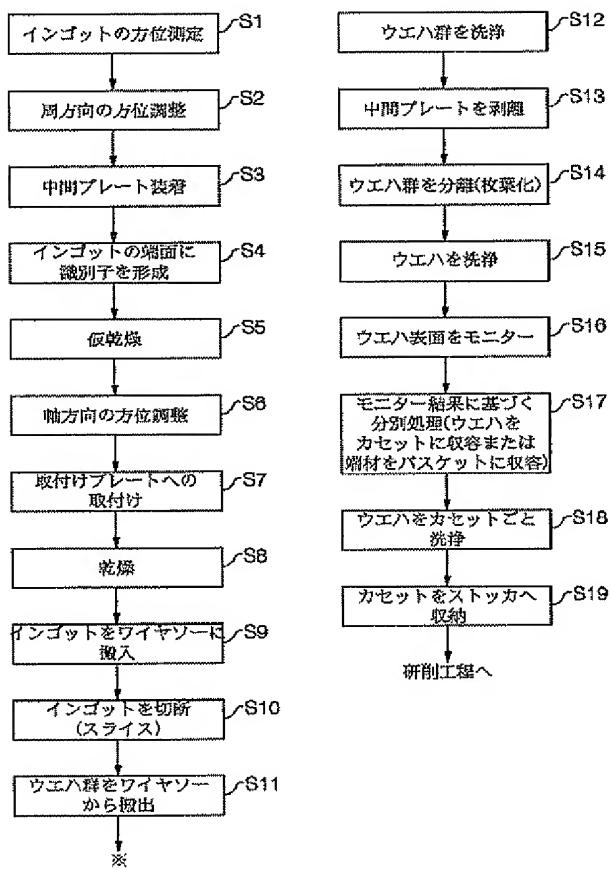
## 【手続補正1】

【補正対象書類名】図面

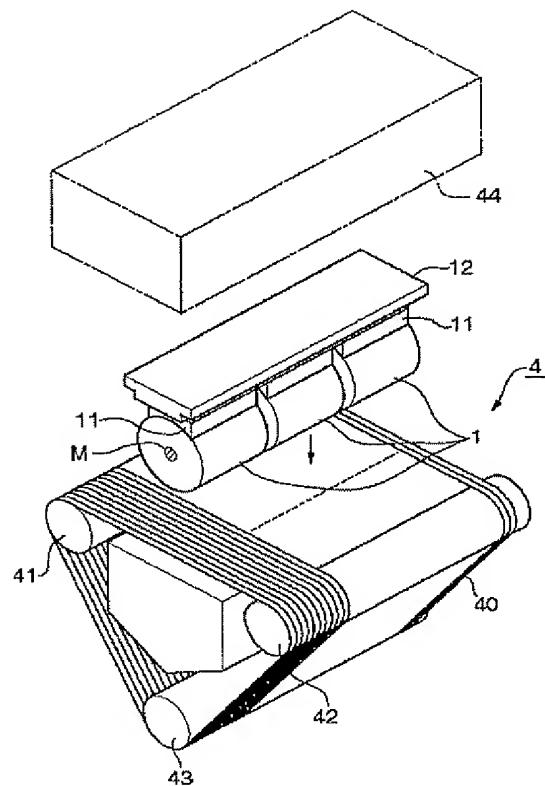
## 【補正対象項目名】全図

【補正方法】変更  
【補正内容】

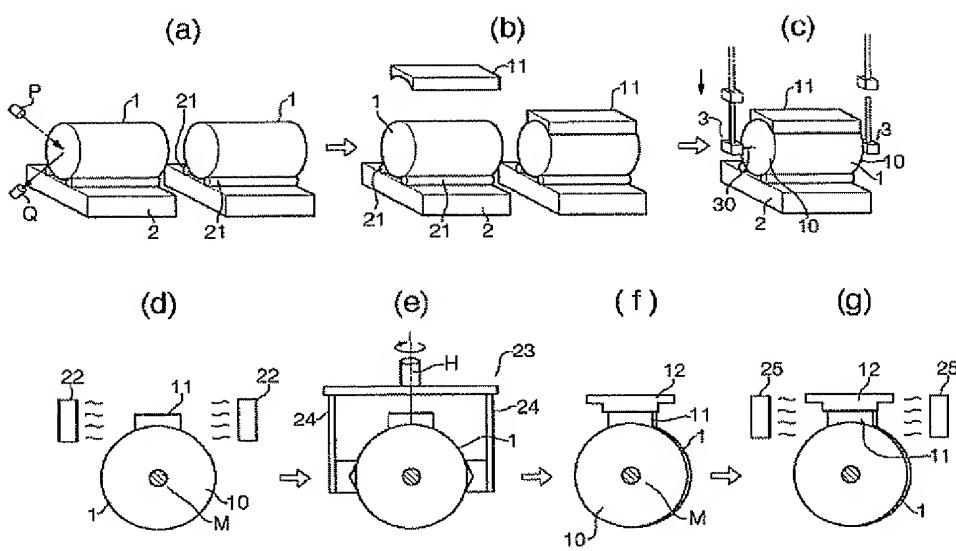
【図1】



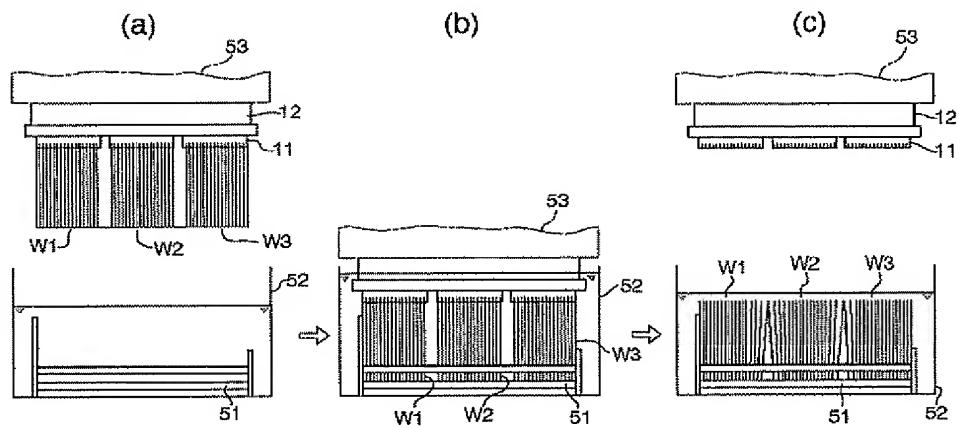
【図3】



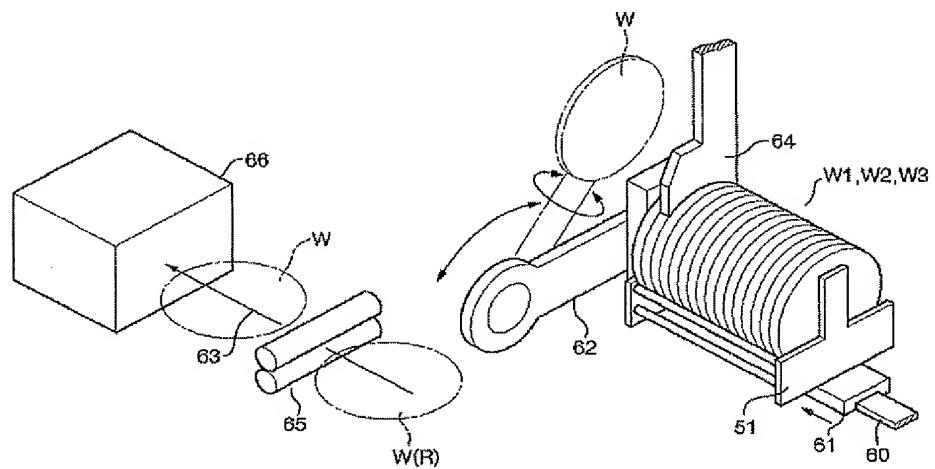
【図2】



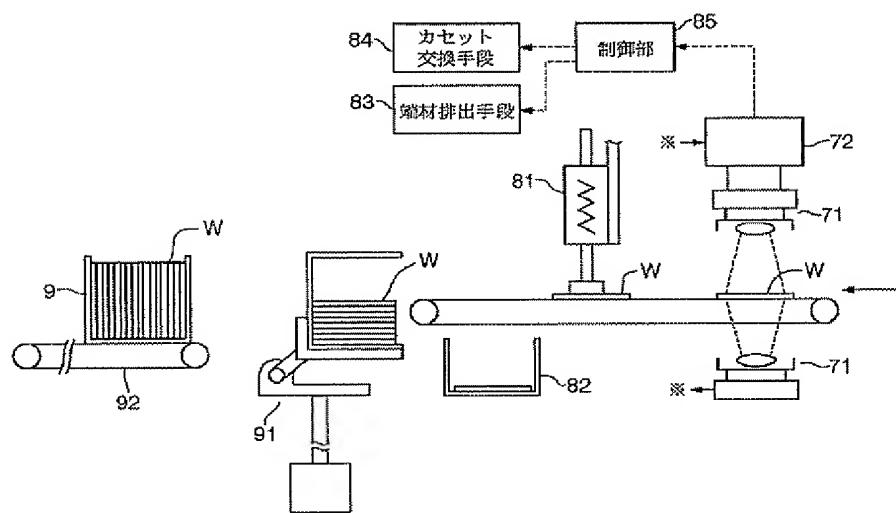
【図4】



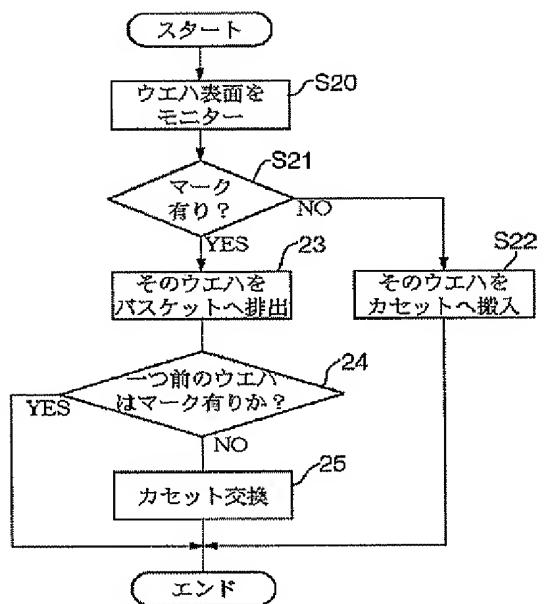
【図5】



【図6】



【図7】



【図8】

